



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20121015004
2012 年 11 月 7 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HPA PCM1803ADB 製品 組立検査サイト追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Test	<input checked="" type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling	<input type="checkbox"/> -	
変更内容	HPA PCM1803ADB 製品 組立検査サイト追加 現行 : NST 社(日本) 変更後 : NST 社(日本), TI-Malaysia(マレーシア)			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2013年2月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input checked="" type="checkbox"/> 計画	<input type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input type="checkbox"/> 変更無し	<input checked="" type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) SSOPパッケージ PCM1803ADB製品の組立検査サイトについて、現行 NST社(日本)サイトにて製造していますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-Malaysia(マレーシア)サイトを追加します。部材の変更は下記の通りです。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立検査サイト	NST社(日本)	NST社(日本) TI-Malaysia(マレーシア)

	現行	追加認定
組立サイト	NST	TI-Malaysia
チップ接着剤 部材番号	P194	4042500
モールド樹脂 部材番号	R0912	4211880

理由：供給能力確保の為

詳細：

検査サイトの最終出荷試験内容、条件は、現行と同一で、生産性認定試験により検証されます。

対象製品リスト

対象製品名			
PCM1803ADB	PCM1803ADBG4	PCM1803ADBR	PCM1803ADBRG4

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)及び製品捺印が下記の様になります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)
現行	NST	ASO: HHS
追加認定	TI-Malaysia	ASO: MLA



図1 出荷ラベルの例

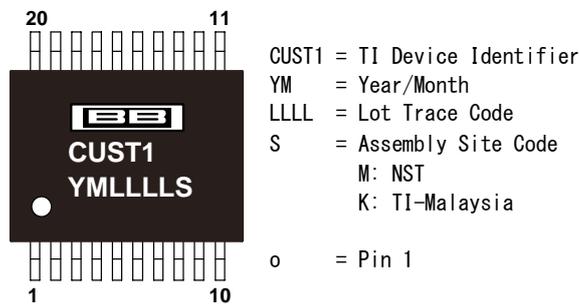


図2 製品捺印の例

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012年12月	終了	2013年1月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	PCM1803ADBR	-	-	
Assembly Site:	TI-MLA	Package/Code/Pins:	SSOP/DB/20	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4211880	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C		12	
Manufacturability	per mfg. Site specification		per spec	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年10月18日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN65LVCP22DR		-	-
Assembly Site:	TI-TAI		Package/Code/Pins:	WSON/DQC/10
Mount Compound:	4042500		Mold Compound:	4211880
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au		Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL:	JEDEC L-1/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 240hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 1000Cyc	77/0	77/0	77/0
Manufacturability (Assembly MQ)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年10月18日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN75976A1DL		-	-
Assembly Site:	TI-MLA		Package/Code/Pins:	SSOP/DL/56
Mount Compound:	4042500		Mold Compound:	4211880
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au		Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL:	JEDEC L-2/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 500Cyc	77/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12/0	-	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年10月18日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TL1454ACDBR		-	-
Assembly Site:	TI-MLA		Package/Code/Pins:	SSOP/DB/16
Mount Compound:	4042500		Mold Compound:	4211880
Bond Wire:	0.8 Mil Dia., Au		Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL:	JEDEC L-1/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77/0	77/0	73/0
**Autoclave	121C, 96hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 2000Cyc	77/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12/0	12/0	12/0
Manufacturability (Assembly MQ)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年10月18日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLC320AD77CDBR		-	-
Assembly Site:	TI-MLA		Package/Code/Pins:	SOIC/DB/28
Mount Compound:	4042500		Mold Compound:	4211880
Bond Wire:	1.20 Mil Dia., Au		Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL:	JEDEC L-1/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		Lot#1	Lot#2	Lot#3
**High Temp. Storage Bake	170C, 420hrs	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96hrs	77/0	77/0	77/0
**T/C	-65C/150C, 1000Cyc	77/0	77/0	77/0
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12/0	-	-
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved	Approved	Approved
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2012年10月18日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPA4860DR		-	-
Assembly Site:	TI-TAI		Package/Code/Pins:	SOIC/D/16
Mount Compound:	4042500		Mold Compound:	4211880
Bond Wire:	1.15 Mil Dia., Au		Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL:	JEDEC L-1/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
**Autoclave	121C, 96hrs	77/0		
**T/C	-65C/150C, 500Cyc	77/0		
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12/0		
Manufacturability	per mfg. Site specification	Approved		
Note: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				